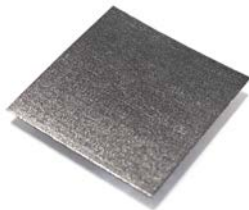


超高导热柔性石墨烯垫片

HGP系列是一种非常柔软的石墨烯取向垫片。具有超低热阻、低密度、易安装、可返工的优点。



特性和优点

- 低密度
- 高压缩
- 超高导热
- 低有效热阻

典型应用

- GPU, CPU封装内
- 光模块等高功率模组
- 高功率通讯基站芯片模组

典型属性		
属性	典型值	参考方法
颜色	灰黑色	目视
厚度(mm)①	0.3±10%	ASTM D374
标准片材(mm) ②	60*60	ASTM D5946
密度(g/cc)	<0.95	ASTM D792
压缩率(%) @40psi	≥30	ASTM D575
压缩应力(psi) @50%	≤80	ASTM D575
回弹性(%)	≥60	ASTM D575
蠕变性(mm)	≤1	ASTM D575
热阻(°C·cm²/W) @40psi	≤0.06	ASTM D5470
工作温度范围(°C)	-40 ~ 150	IEC 60068-2-14
保质期(年)	2	避免曝晒 储存温度：≤30°C 储存湿度：≤70% 堆放高度不超过5层， 而且总高度不超过1M
注：①厚度范围：0.2-2.0mm ②最大尺寸：100*100mm ③可包边可点胶		